

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-058

通富微电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期内公司从事的主要业务

（1）公司主要业务情况

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局七大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有近两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和

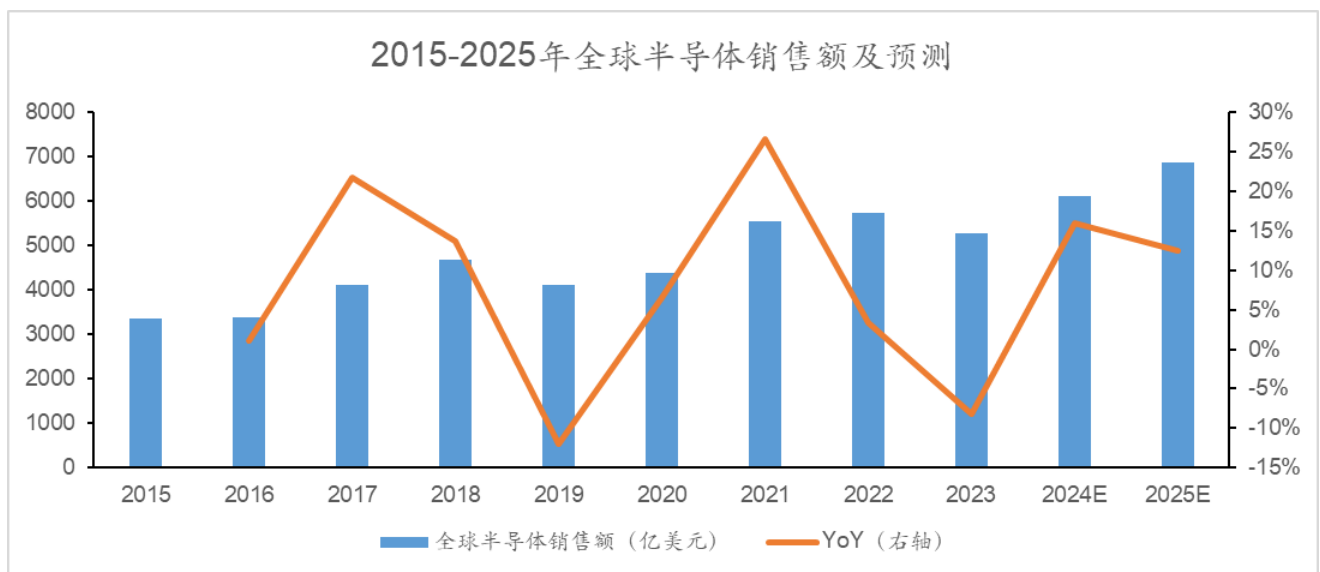
市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

(2) 公司所处行业情况

1) 2024 年上半年半导体市场情况

在信息技术发展的浩瀚星空中，半导体与集成电路不仅是璀璨夺目的星辰，更是驱动整个经济社会高速发展的核心引擎之一。作为战略性、基础性和先导性产业，它们不仅承载着技术创新的重任，更是保障国家安全、促进产业升级的关键力量。2024 年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势。据半导体行业协会（SIA）统计，2024 年上半年全球半导体销售额较 2023 年同期增长；从单季度看，2024 年 Q2 全球半导体销售额同比及环比均实现增长，行业呈现持续改善态势。同时，半导体行业协会（SIA）预计 2025 年全球半导体销售额亦将实现大于 10% 的增长。

图表：2015-2025 年全球半导体销售额及预测（单位：亿美元）



来源：SIA

具体而言：

半导体行业在经历了 2022-2023 年的去库存后，2024 年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC 设计公司和半导体经销商的库存周转在 2023 年 Q1 达到高点后，连续三个季度下降，并在 2023 年 Q4 触底，2024 年 Q1 末平均周转天数较去年同期减少了 69.78 天，表明行业去库存进展顺利。

从下游应用领域看。AI 需求爆发带动逻辑和高端存储需求快速反弹。消费电子回暖复苏，2024 年上半年全球智能手机销量 5.75 亿部，同比增近 7.2%；中国 2024 年 618 购物节智能手机销量同比增长 7.4%；据 SEMI 统计，消费电子复苏带动全球 IC 库存水位同比下降 2.6%。而在汽车和工业领域，2024 年上半年整体需求较弱，展望下半年，随着车规级芯片和工控芯片市场逐步触底，汽车和工业需求有望重回增长。

在行业景气整体复苏的同时，在 AI 革命催化下先进封装正迎来加速发展。一方面，AI 需求爆发持续拉升对先进封装的需求；另一方面，AI 算力正实现从训练到推理、从云端到端侧的转向，这种趋势亦推动先进封装技术正变得日益多元化。

2) 行业相关国家政策

2024 年 7 月 25 日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在消费品以旧换新方面，该措施将个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新等一并纳入超长期特别国债资金支持范围。东海证券认为，随着国家以旧换新政策力度加大，家电、汽车等消费品的更新周期有望进一步加速，家电领域的智能化和网联化有望拉动对 WiFi、蓝牙等无线连接芯片的需求，汽车产业自主品牌渗透率持续提升也有望带动功率、MCU、传感器等本土产业链逐渐崛起。

2024 年 7 月 26 日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，国务院国资委科技创新局负责人方

磊表示，国务院国资委把加快发展人工智能作为产业焕新行动和启航行动部署的主要方向，开展“AI+”专项行动。致力于加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展。

(3) 报告期公司经营情况

1) 抓住行业复苏势头，各类业务稳步提升

2024 年起，随着计算和移动设备等消费电子产品市场的回暖，全球半导体行业迎来了明显复苏势头。

上半年，在消费市场方面，公司持续紧抓手机及消费市场复苏机遇，传统框架类产品市场稳定，营收实现不断提高。在新兴市场方面，射频产品市场国产替代势如破竹，公司把握先机，系统级（SiP）封装技术的射频模组、通讯 SOC 芯片等产品不断上量，持续扩大市场规模；同时，存储器（Memory）、显示驱动（Display Driver）、FC 产品线也展现出强劲增长势头，保持超 50% 的高速增长，展现了公司新兴产品线强劲的市场竞争力和生产效率。

上半年，AI 芯片市场规模快速增长。根据 Gartner 预测，2024 年全球 AI 芯片市场规模将增加 33%，达到 713 亿美元，2025 年有望进一步增长 29%，达到 920 亿美元；2024 年服务器 AI 芯片市场规模将达到 210 亿美元，至 2028 年，有望达到 330 亿美元，CAGR 为 12%。公司客户 AMD 的数据中心业务超预期增长，得益于云客户和企业客户对 Instinct GPU 和 EPYC 处理器的强劲需求，其中 MI300 GPU 单季度超预期销售 10 亿美元，AMD 上修今年数据中心 GPU 收入为 45 亿美元，此前为 40 亿美元。随着 AI 芯片需求的暴涨，先进封装产能成为了 AI 芯片出货的瓶颈之一，台积电、日月光、安靠均表示先进封装产能紧张、相关订单需求旺盛。在先进封装市场方面，公司持续发力服务器和客户端市场大尺寸高算力产品。依托与 AMD 等行业龙头企业多年的合作积累与先发优势，基于高端处理器和 AI 芯片封测需求的不断增长，公司上半年高性能封装业务保持稳步增长。同时，随着 AI+ 行业创新机会增多，人工智能产业化进入新阶段，公司配合 AMD 等头部客户人工智能发展的机遇期要求，积极扩产槟城工厂，全方位满足客户需求。

机遇往往与挑战共存，上半年工控及功率半导体市场下游需求相对疲弱，全球游戏机市场整体呈现低迷状态。面对上半年市场挑战，公司积极采取应对措施，通过调整优化客户结构等方法来减轻市场变化对公司经营的潜在影响，通过构建更加稳健和多元化的客户基础，增强公司在不断变化的市场环境中的适应能力和竞争力。

得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，2024 年上半年，公司实现营业收入 110.80 亿元，同比增长 11.83%。

公司凭借有效的成本控制、先进的技术管理能力以及快速响应和优质交付等方面的优异表现，连续四年荣获德州仪器（TI）“卓越供应商”奖项。通富超威苏州连续 8 次在 AMD 季度质量评分中获得第一名。

在当前全球半导体产业的复杂多变生态环境中，公司凭借卓越的技术创新能力、优良的产品质量以及专业的客户服务，获得了市场的高度认可，公司目前已成为多家客户本土化生产的首选合作伙伴。公司将全方位助力客户实现技术突破和产品升级，共同开拓更广阔的市场空间。

展望下半年，我们认为消费市场仍然会维持复苏状态，同时算力需求将保持增长，工规和车规市场已逐步触底，工业芯片与汽车芯片的成长空间仍然可观。公司在汽车电子领域已深耕 20 余年，与国际一流汽车半导体厂商深度合作，积累了丰富的经验，在汽车电子领域的份额占比保持领先，并逐年提升。同时，公司在持续夯实欧美头部客户的基础上，积极开拓国内市场新客户，扩大国内市场营收。

在先进封装布局方面，公司面向高端处理器等产品领域持续投入，进一步加大研发力度，布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台，全方位配合海内外客户的发展需求，拓展先进封装产业版图，为新一轮的需求及业务增长夯实基础，带动公司在先进封装产品领域的业绩成长。

2) 公司技术研发水平不断精进

2024 年上半年，公司对大尺寸多芯片 Chiplet 封装技术升级，针对大尺寸多芯片 Chiplet 封装特点，新开发了 Corner fill、CPB 等工艺，增强对 chip 的保护，芯片可靠性得到进一步提升。公司启动基于玻璃芯基板和玻璃转接板的 FCBGA 芯片封装技术，开发面向光电通信、消费电子、人工智能等领域对高性能芯片的需求。此项技术有助于推动高互联密度、优良高频电学特性、高可靠性芯片封装技术的发展，目前已完成初步验证。Power 方面，公司上半年完成了 Easy3B 模块的研发，开始进入小批量量产，国内首家采用 Cu 底板灌胶模块，应用于太阳能逆变器，相对于市场传统的 Easy1B、2B 模块，能更有效的降低系统的热阻及功耗。2024 年上半年，公司 16 层芯片堆叠封装产品大批量出货，合格率居业内领先水平；国内首家 WB 分腔屏蔽技术、Plasma dicing 技术进入量产阶段。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在知识产权方面取得了显著成果。累计申请专利达 1,589 件，其中发明专利占比近

70%。同时，累计软著登记 93 件。在江苏省高价值专利培育项目中期检查中，公司获评“优秀”。

3) 重大工程建设稳步推进，保障发展空间

2024 年上半年，通富通科、南通通富三期工程、通富超威苏州、通富超威槟城新工厂等一批公司重大项目建设稳步推进，施工面积合计约 11.38 万平米，为未来扩大生产做好充足准备。上半年，公司子公司通富通达获得了 217 亩土地摘牌；南通通富一层 2D+项目机电安装工程及南通通富二层 SIP 建设项目机电安装改造施工完成，均一次性通过消防备案；同时，还进行了通富超威苏州新工厂机电安装工程、通富超威槟城新工厂 bump 生产线建设工程以及槟城新工厂先进封装生产线建设工程，公司重大项目建设持续稳步推进，满足公司当前及未来生产运营发展所需，持续增强企业发展后劲。

4) 全方位推进人力资源工作，促进公司长远发展

随着科技日新月异的发展，公司在 2024 年上半年继续秉承“科技引领未来，人才驱动发展”的战略理念，不断深化人才培养、发展与激励机制，为公司的持续创新和稳健增长奠定了坚实的基础。

①领导力深化与传承

2024 年上半年，公司进一步强化了干部的领导力培养，通过引入张謇学院、世界性企管训练的领导力品牌——卡内基训练等先进的领导力发展项目，结合公司实际情况，定制化组织相关培训课程。同时，实施“导师制”，让经验丰富的领导者一对一指导新晋干部，加速其成长步伐。此外，公司还加大了对年轻潜力人才的挖掘和培养力度，为公司未来发展储备了丰富的人才。

②专业能力提升

针对电子高科技行业的快速发展，公司组织了多场专业技能培训和研讨会，涵盖了前沿技术、产品研发、市场趋势等多个领域。通过外部专家授课、内部经验分享等方式，不断提升员工的专业素养和技能水平，确保公司在技术上的领先地位，促进高质量发展，共建新质生产力。

③多样化人才队伍建设

公司深知多样化对于创新的重要性，因此继续加大力度吸纳来自不同背景、专业和文化的优秀人才。通过优化招聘流程、拓宽招聘渠道、加强校企合作等措施，公司成功吸引了大量具有创新思维和实践能力的多样化人才加入公司，为团队注入了新的活力。

④人才激励与留任

为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，公司实行了第一期员工持股计划。2024 年 5 月，公司第一期员工持股计划预留份额锁定期届满，达到解锁条件。2024 年 6 月，公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满，达到解锁条件。截至 2024 年 6 月 19 日，公司第一期员工持股计划已在各锁定期届满后通过集中竞价交易的方式将所持股份全部出售完毕。随后，公司召开董事会，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。员工持股计划的开展，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，留住人才、激励人才，建立公司与员工双方利益共享和风险共担的长效机制，夯实公司业务发展的组织和人才基础，促进公司长远可持续发展。

展望未来，公司将继续坚持人才优先的战略导向，不断深化人才培养、发展与激励机制创新。公司将以更加开放的心态和包容的文化吸引更多优秀人才加盟，共同推动公司在电子高科技领域的持续创新和发展。

3、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,080,086,982.96	9,907,892,175.21	11.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,663,289.17	-187,693,998.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,478,415.93	-261,421,813.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,844,455,652.90	1,481,483,490.80	24.50%
基本每股收益（元/股）	0.2130	-0.1244	不适用

稀释每股收益（元/股）	0.2130	-0.1243	不适用
加权平均净资产收益率	2.29%	-1.37%	3.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	36,114,374,973.31	34,877,709,853.20	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,290,262,970.31	13,917,141,774.57	2.68%

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	236,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19.90%	301,941,893	0	质押	91,510,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.26%	170,817,547	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	52,480,179	0	不适用	0
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	3.36%	50,932,648	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58%	23,959,036	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.35%	20,519,835	0	不适用	0

国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	14,680,644	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	12,655,077	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	9,292,160	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.35%	5,300,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东参与转融通业务的情况见下表。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—国泰CES半	11,512,960	0.76%	2,115,900	0.14%	9,292,160	0.61%	1,443,200	0.10%

导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金								
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,842,477	0.39%	1,714,300	0.11%	12,655,077	0.83%	485,800	0.03%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,948,048	1.18%	32,300	0.00%	14,680,644	0.97%	58,100	0.00%
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	26,021,036	1.72%	776,600	0.05%	23,959,036	1.58%	225,100	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无

通富微电子股份有限公司

董事长：石磊

2024 年 8 月 27 日